

RECRUTEUR	PYXALIS		
Lieu	MOIRANS (38) - Centr'Alp		
Libellé de la Fonction	Ingénieur en développement packaging circuits intégrés pour solutions d'imageries		
Rapporte à	Directrice des opérations		
Catégorie	<input type="checkbox"/> Employé <input type="checkbox"/> ATAM <input checked="" type="checkbox"/> Cadre	Type de poste :	<input type="checkbox"/> 35 heures/ semaine <input checked="" type="checkbox"/> Forfait jours
		<input checked="" type="checkbox"/> CDI <input type="checkbox"/> CDD	
RAISON D'ÊTRE			
<p>Pyxalis est une société indépendante de référence dans le développement et la vente de solutions spécifiques de capteurs d'images innovants, performants et industrialisables sur une large gamme de marchés et applications allant du très faible au fort volume.</p> <p>Elle recherche un ingénieur développement packaging pour soutenir sa croissance et augmenter sa capacité à développer, industrialiser et produire des nouvelles solutions d'imagerie dans un mode fables.</p>			
ENGAGEMENT			
<p>Dans le cadre de ses fonctions, l'engagement du titulaire réside dans l'élaboration des solutions d'encapsulations des puces : étude, proposition/conception, la spécification, validation, l'industrialisation et qualification ainsi que le suivi technique de la sous-traitance associée (contexte fables) permettant de répondre aux exigences du produit</p> <p>En complément des fonctions de développement packaging, qui peuvent ne mobiliser le titulaire que sur une partie du temps de travail, il sera demandé au titulaire du poste de prendre en charge des actions d'ingénierie produits ou de gestion de projets, suivant le temps imparti (cf descriptifs spécifiques)</p>			
MAITRISE NECESSAIRE POUR TENIR SES ENGAGEMENTS			
<p>Afin de tenir ses engagements, le titulaire doit maîtriser les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concevoir le cahier des charges de la solution de packaging (boîtier et assemblage) à partir de la spécification de besoin du produit, (technique – environnementale - fiabilité – économiques). Identifier les coûts en coopération avec les achats. Définir les plannings. Identifier les risques. • Participer au choix des sous-traitants et fournisseurs de solutions d'encapsulation en coopération avec les Achats, en apportant l'expertise technique et industrielle nécessaire l'évaluation • Construire le « statement of work » (SOW) pour les fournisseurs et sous-traitants du domaine (boîtier et assemblage) et en assurer le suivi en coopération avec les achats et le chef de projet produit. Le SOW couvrira en particulier les aspects activités, livrables, planning, recette • Garantir en interne Pyxalis la connaissance de l'offre technique des fournisseurs ; dans le cadre des RFI et des RFQ, orienter les équipes sur des choix industriels et compatibles de la capacité fournisseur • Coopérer avec l'ingénieur produit en charge du suivi de production d'assemblage en lui apportant le soutien technique nécessaire à la réalisation des audits techniques, traitements des aléas technique (hold), identifications des axes techniques de réduction de coût de fabrication, des analyses et traitements des PCN, NC, 8D • Effectuer de la veille technologique en particulier sur l'évolution des boîtiers & procédés d'assemblage pour les capteurs d'images pour proposer des solutions innovantes et à l'état de l'art de la profession. 			

LIEN DE COOPERATION

- Achat : le titulaire est le référent technique dans le domaine du packaging et de l'assemblage vis-à-vis des achats /fournisseurs & sous-traitants
- Ingénieur produit : le titulaire est le référent technique pour la validation, l'industrialisation et le suivi de production de son domaine technique (packaging & assemblage)
- Ingénieur de test / caractérisation : le titulaire est le référent technique pour garantir la compatibilité des solutions packaging choisies avec les moyens de test et de caractérisation
- Chef de projet : le titulaire est le référent technique packaging/assemblage du chef de projet sur les parties conception, prototypage, industrialisation et qualification (planning, coût, prix de revient, avancement, analyse de risques)
- Concepteurs : le titulaire est le référent technique concernant la compatibilité de la conception avec les solutions packaging (assemblage et boîtier)

LATITUDES MANAGERIALES ET COMPORTEMENTALES

Prise de décision technique autonome dans le respect du contour projet : spécification, estimer et assurer les délais, maîtrise des aléas techniques...

- Transversales
 - Ecoute et satisfaction du client
 - Devoir d'entreprendre, de coopération et engagement pour réussir
 - Esprit d'équipe
 - Retour d'expérience, Amélioration continue, Résolution de problème
- Spécifiques
 - Planification / Organisation
 - Réactivité
 - Hauteur de vue

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE

5 ans d'expérience minimum dans le domaine de la conception de boîtier et de l'assemblage semiconducteurs, de préférence dans le domaine du capteur d'images

FORMATION REQUISE ET COMPETENCES SPECIFIQUES

- *Savoir*
 - Formation Ingénieur ou Bac +5 Matériaux / Micromécanique / Physique / Optique
 - +5 ans d'expérience dans le domaine
 - Expérience avec les process d'assemblage si possible en imagerie
 - Connaissance des principaux métiers du segment considéré (assemblage, packaging)
 - Connaissance des concepts et outil de management de la qualité et de la production (audit, référentiels normatif, DOE, Benchmarking, etc.)
- *Savoir-faire*
 - Management de projet, planification et organisation d'activité
 - Négociation, communication externe et interne
 - Anglais : courant
 - Maîtrise des outils de conception, de simulation et de modélisation en mécanique, thermique, électromagnétisme, DOE, etc.
 - Développement et industrialisation de filières technologiques d'assemblage
 - Connaissance pratique des outils qualité (MSP, plans d'expériences, AMDEC, etc.)